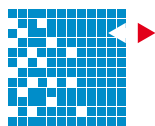


Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,



edaWorkshop 09

Die „Submission-Deadline“ für die Einreichung von Beiträgen zum edaWorkshop ist der 11.11.2008. Nähere Informationen unter www.edacentrum.de/edaworkshop

„der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!“ – während die Kinder fröhlich die Zeit der Ernte, der mannigfaltigen Blattfärbungen und der Winde begrüßen, trauert der eine oder die andere dem ausgebliebenen Spätsommer nach, der nun endgültig passé zu sein scheint. Wir Mitarbeiter vom edacentrum haben den Ausklang des Sommers genutzt, um uns bei einem gemeinsamen Team-Seminar (s. Abb 0.03) neue Ideen zu holen und wir können sagen, dass es sich gelohnt hat.

Genauso plötzlich, wie die Temperaturen gesunken sind, sind allerdings auch weltweit die Aktienkurse gesunken und Panik macht sich breit. Die täglichen Horrormeldungen der Banken führen auch zu deutlichen Kurseinbußen bei Technologie-Firmen (siehe Musterdepot auf S. 19). Sicherlich ist dies oft der bekannte Herdentrieb, denn es gibt auch Firmen, die weiterhin Gewinne machen, und dennoch Kursverluste verzeichnen müssen. Geben wir daher die Hoffnung nicht auf, denn der Herbst ist traditionell im Chipdesign eine starke Jahreszeit. Da inzwischen ja auch in Süddeutschland die Ferienzeit zu Ende ist, klingeln die Telefone wieder öfter und die Terminpläne füllen sich, so dass wir wohl doch einen goldenen Herbst erwarten können. Kein Wunder, dass auch das edacentrum wieder einmal Veranstaltungen ankündigt:

Das edaForum kommt in diesem Jahr wieder nach Dresden, nach 2004 jetzt zum zweiten Mal. Das ausführliche Programm ist kürzlich fertig gestellt und verschickt worden. In diesem newsletter edacentrum finden Sie die Fotos der Vortragenden (S. 24–25) und auf S. 23 die Ankündigung der konzeptionell veränderten Company Presentations, sowie den Hinweis auf unser „edaBundle“ aus edaForum08 und „edaTrend DAC08“. Und wer sich gefragt hat, was dieses merk-

würdige Memory auf der Titelseite zu bedeuten hat, der hat jetzt auch eine Antwort.

Ebenfalls in Dresden wird im nächsten Jahr vom 26.–28. Mai der edaWorkshop09 stattfinden, der gemeinsam mit der CATRENE/MEDEA+-DAC in englischer Sprache veranstaltet wird. Der 27. Mai stellt dabei den gemeinsamen Teil beider Veranstaltungen dar. Um eine gute programmatische Abstimmung beider Veranstaltungsteile zu ermöglichen, ist der Call for Papers (S. 33) zum edaWorkshop09 bereits Anfang August verteilt und die „Submission-Deadline“ dieses Mal auf den 11.11.08 vorgezogen worden.

Neben dieser „Doppelvorschau“ halten wir in diesem Heft auch eine doppelte Rückschau: Zum einen holen wir die verschobene Berichterstattung von den technischen Sessions des edaForum07 nach (S. 26ff) und liefern außerdem den zweiten Teil der Berichterstattung vom diesjährigen edaWorkshop (S. 20ff).

Darüber hinaus finden Sie natürlich auch in diesem newsletter edacentrum einen ausführlichen Projektspiegel, bestehend aus dem umfassenden Bericht vom Projekt MAYA, einem Kurzbericht vom Projekt HONEY und einem Fachartikel zur formalen Verifikation.

Die Redaktion hofft, dass Sie dieser newsletter edacentrum auf ein sicherlich ereignisreiches letztes Quartal einstimmt. Wir wünschen Ihnen wie immer eine interessante Lesezeit mit diesem Heft!

Ralf Popp für das edacentrum



Der „edaTrend DAC08“ ist am 16. Juli 2008 erschienen und kann unter www.edacentrum.de/edatrend/shop bestellt werden.

Was war:

Abbildung 0.1:

Prof. Dr. Georges Gielen war Keynote-Speaker einer der beiden Technical Sessions auf dem edaForum07

Abbildung 0.2:

Volker Kiefer hielt eine der beiden Keynotes auf dem edaWorkshop08 (S. 28).

Abbildung 0.3:

Teamseminar sorgt für neue Ideen am edacentrum

Abbildung 0.4:

Ergänzende Informationen zum newsletter edacentrum finden Sie unter www.edacentrum.de/newsletter/



Abbildung 0.01



Abbildung 0.02



Abbildung 0.03



Abbildung 0.04